

三季度报业绩高增，看好国产替代景气持续

—电子行业周报 20211101

电子行业周报

2021年11月01日

报告摘要:

● 市场整体下跌，半导体上涨4.49%

上周(2021/10/22-2021/10/29)市场整体下跌，半导体指数上涨4.49%。其中：半导体设计+4.0%、半导体制造-0.8%、半导体封测-1.1%、半导体材料+1.1%、半导体设备+2.3%、功率半导体+2%。上周费城半导体指数上涨，涨幅为1.69%，台湾半导体指数上周上涨1.17%，截至上周(2021/10/29)，A股半导体公司总市值达31,779亿元，环比+1.49%，对应2021年整体PE为57.59倍。

● 三季度报业绩高增，设计与功率板块领衔

设计：行业高景气持续+国产替代，行业迎来黄金窗口期，Q3单季归母净利润同比增速在-120.95%-11539.41%区间。晓程科技同增11539%，居设计行业首位。MCU方面，兆易创新Q3单季归母净利润8.62亿元，同比+179%；中颖电子Q3归母净利润1.2亿元，同比+104%；模拟龙头圣邦股份Q3归母净利润1.9亿元，同比+86%，位于业绩预告期间上限。CIS龙头韦尔股份Q3归母净利润12.8亿元，同比+73%，高于业绩预告区间中值。

封测：高景气持续，封测厂产线持续满载，Q3单季归母净利增速在-4.04%-130.22%区间。其中中华天科技同增132%，居封测行业首位。

设备：持续受益于国内产线扩产，Q3单季归母净利增速在42%-341.02%区间。其中长川科技同增341%，居设备行业首位。设备龙头北方华创Q3归母净利润3.48亿元，同比+144%。

材料：国产替代加速，Q3单季归母净利增速在-115%-3420%区间，南大光电Q3归母净利润同增3412%，居材料行业首位，硅片领军企业立昂微Q3归母净利润同增257%，部分材料企业由于上游原材料价格上涨和限电的影响，21Q3业绩并未完全释放，未来随着不利因素的逐渐缓解和国产替代加速，半导体材料企业业绩有望迎来持续增长。

功率：行业高景气持续&国产替代加速，Q3单季归母净利增速在-40%-6040%区间，华微电子同增6031%，领跑功率板块。斯达半导、士兰微、新洁能均实现业绩大幅增长，继续看好下游需求高增长、国产替代加速的IGBT高景气“赛道”。

● 投资建议

持续推荐：韦尔股份、兆易创新、斯达半导、时代电气、芯源微。

● 风险提示

下游代工扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度

盈利预测与财务指标

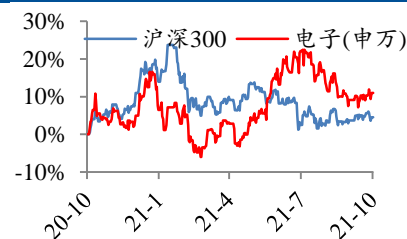
代码	重点公司	现价 10月29日	EPS			PE			评级
			2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	
603501	韦尔股份	266	3.11	5.19	7.36	85	51	36	推荐
603986	兆易创新	170	1.32	2.92	4.21	128	58	40	推荐
603290	斯达半导	400	1.13	2.18	3.03	354	184	132	推荐
688187	时代电气	54	1.75	1.60	2.04	31	34	26	推荐
688037	芯源微	197	0.58	1.10	1.99	339	180	99	推荐

资料来源：公司公告、民生证券研究院

推荐

维持评级

行业与沪深300走势比较



资料来源：Wind，民生证券研究院

分析师：王芳

执业证号：S0100519090004

电话：021-60876730

邮箱：wangfang@mszq.com

分析师：杨旭

执业证号：S0100521050001

电话：021-60876730

邮箱：yangxu_yj@mszq.com

分析师：王浩然

执业证号：S0100521040001

电话：021-60876730

邮箱：wanghaoran@mszq.com

研究助理：赵晗泥

执业证号：S0100120070021

电话：021-60876730

邮箱：zhaohanni@mszq.com

相关研究

- 1.【民生电子】半导体周跟踪：三季度报持续披露，兑现国产替代与高景气逻辑
- 2.【民生电子】半导体周跟踪：三季度报陆续披露，高增长逻辑再次兑现（更正报告）

目录

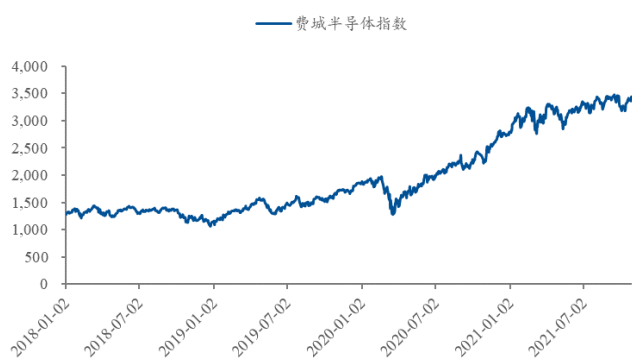
1	行情回顾：市场整体下跌，半导体上涨 4.49%.....	3
2	行业新闻	11
3	三季报业绩高增，设计与功率板块领衔.....	14
3.1	设计	14
3.2	封测	17
3.3	设备	17
3.4	材料	18
3.5	功率	19
4	投资建议	22
5	风险提示	23
	插图目录	24
	表格目录	24

1 行情回顾：市场整体下跌，半导体上涨 4.49%

上周（2021/10/22-2021/10/29）市场整体下跌，沪深 300 指数下跌 1.03%，上证综指下跌 2.18%，深证成指下跌 0.29%，创业板指数上涨 2.00%，中信电子上涨 0.83%，半导体指数上涨 4.49%。其中：半导体设计+4.0%、半导体制造-0.8%、半导体封测-1.1%、半导体材料+1.1%、半导体设备+2.3%、功率半导体+2%。

上周费城半导体指数上涨，涨幅为 1.86%，2021/1/1-2021/10/29 涨幅为 22.79%。台湾半导体指数上周下跌 0.66%，2021/1/1-2021/10/29 涨幅为 15.34%。

图1：费城半导体指数持续上涨



资料来源：wind，民生证券研究院

图2：全球半导体月度销售额及增速



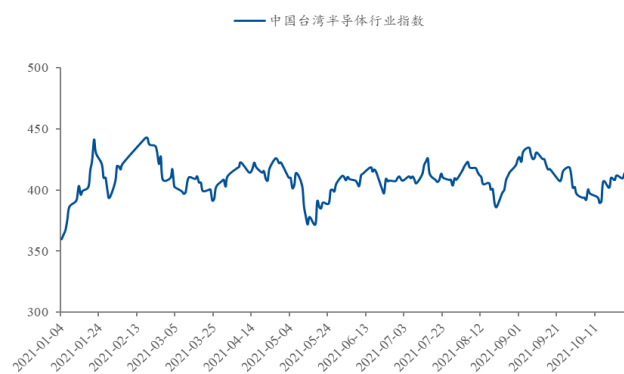
资料来源：wind，民生证券研究院

图3：A股半导体指数



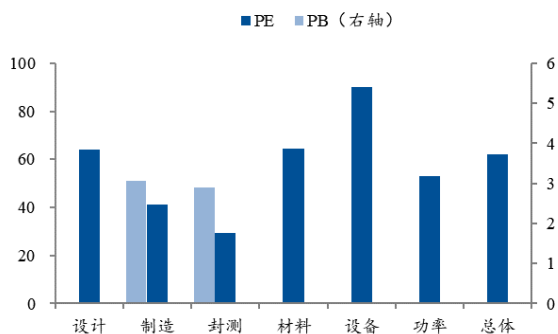
资料来源：wind，民生证券研究院

图4：台湾半导体指数



资料来源：wind，民生证券研究院

图5: 2021-10-29 细分板块估值情况



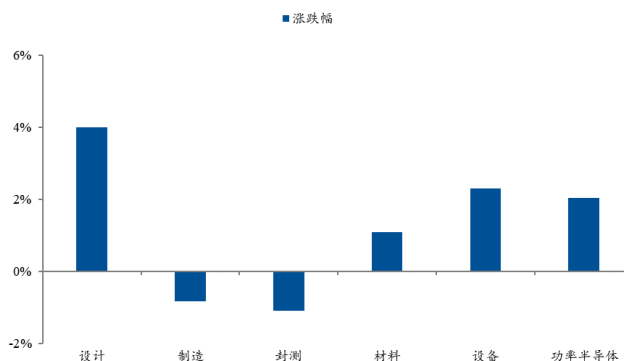
资料来源: wind, 民生证券研究院

注: PE=最近市值/2021年wind一致预期净利润

注: PB=最近市值/2021年wind一致预期净资产

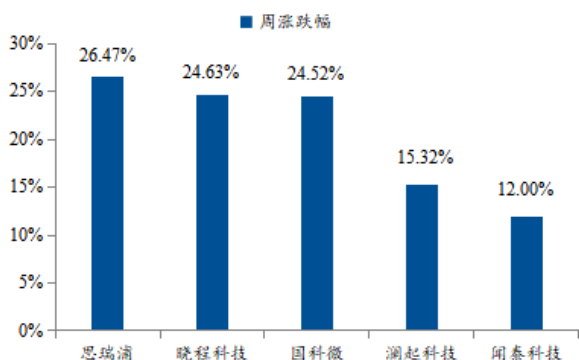
上周(2021/10/22-2021/10/29)半导体行业涨幅前五公司为思瑞浦(+26.47%)、晓程科技(+24.63%)、国科微(+24.52%)、澜起科技(+15.32%)和闻泰科技(+12.00%)，涨幅后五的公司敏芯股份(-20.12%)、乐鑫科技(-15.90%)、上海贝岭(-15.66%)、华润微(-10.55%)和国民技术(-10.00%)。

图6: 上周半导体各细分板块涨跌幅情况



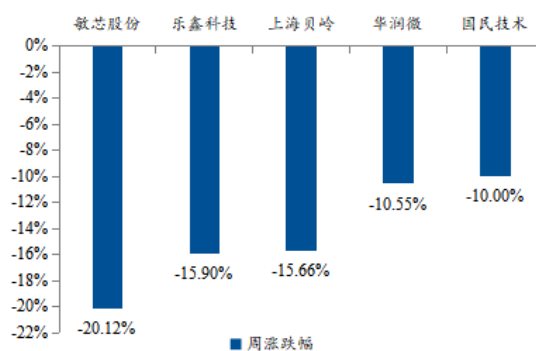
资料来源: wind, 民生证券研究院

图7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司



资料来源: wind, 民生证券研究院

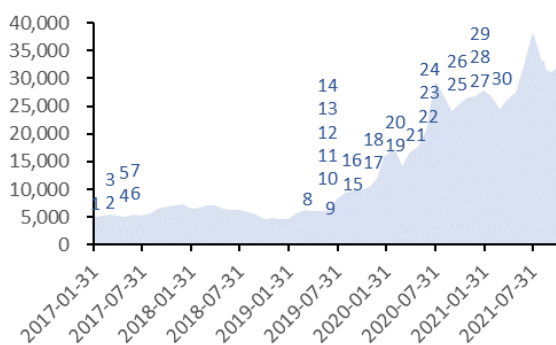
图8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司



资料来源: wind, 民生证券研究院

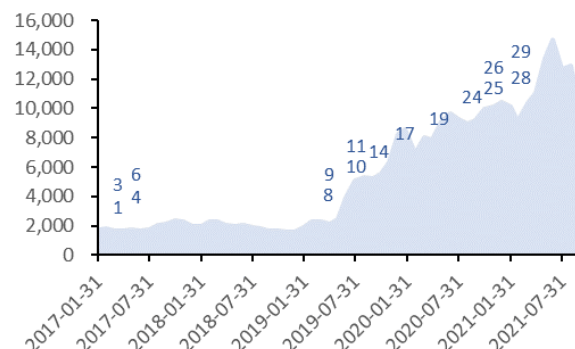
截至上周（2021/10/29），A股半导体公司总市值达31,779亿元，环比+1.49%。其中：设计板块公司总市值12,459亿元，环比+2.90%；制造板块公司总市值7,594亿元，环比-0.9%；设备板块公司总市值5,374亿元，环比+2.2%；材料板块公司总市值4,555亿元，环比+1.7%；封测公司总市值1,797亿元，环比-0.6%。

图9: A股半导体板块公司总市值（十亿元）



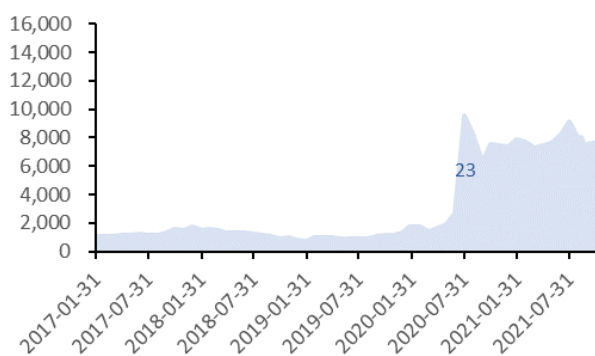
资料来源: wind, 民生证券研究院

图10: A股半导体设计板块公司总市值（十亿元）



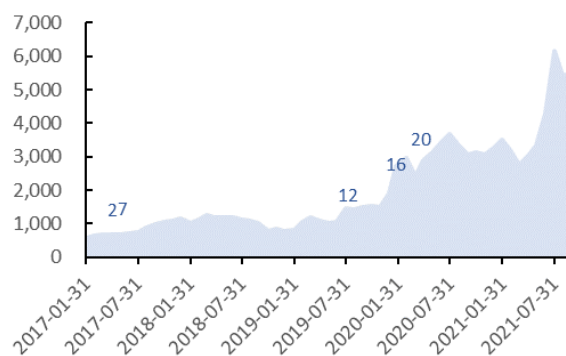
资料来源: wind, 民生证券研究院

图11: A股半导体制造板块公司总市值（十亿元）



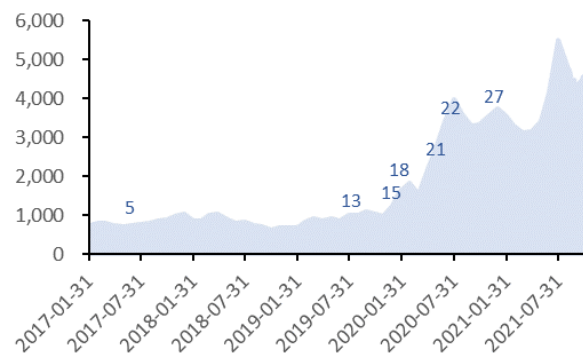
资料来源: wind, 民生证券研究院

图12: A股半导体设备板块公司总市值（十亿元）



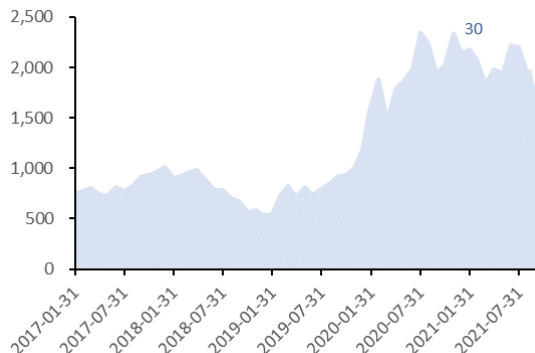
资料来源: wind, 民生证券研究院

图13: A股半导体材料板块公司总市值（十亿元）



资料来源: wind, 民生证券研究院

图14: A股半导体封测板块公司总市值（十亿元）



资料来源: wind, 民生证券研究院

- 注 1: 2017/2/20 富瀚微 (300613.SZ) 上市 (影响当月市值 63 亿)
- 注 2: 2017/4/17 长传科技 (300604.SZ) 上市 (影响当月市值 26 亿)
- 注 3: 2017/5/4 韦尔股份 (603501.SH) 上市 (影响当月市值 95 亿)
- 注 4: 2017/6/6 圣邦股份 (300661.SZ) 上市 (影响当月市值 44 亿)
- 注 5: 2017/6/15 江丰电子 (300666.SZ) 上市 (影响当月市值 42 亿)
- 注 6: 2017/7/12 国科微 (300672.SZ) 上市 (影响当月市值 32 亿)
- 注 7: 2017/7/28 中科信息 (300678.SZ) 上市 (影响当月市值 12 亿)
- 注 8: 2019/4/15 博通集成 (603068.SH) 上市 (影响当月市值 69 亿)
- 注 9: 2019/6/18 卓胜微 (300782.SZ) 上市 (影响当月市值 111 亿)
- 注 10: 2019/7/22 乐鑫科技 (688018.SH) 上市 (影响当月市值 132 亿)
- 注 11: 2019/7/22 澜起科技 (688008.SH) 上市 (影响当月市值 874 亿)
- 注 12: 2019/7/22 中微公司 (688012.SH) 上市 (影响当月市值 473 亿)
- 注 13: 2019/7/22 安集科技 (688019.SH) 上市 (影响当月市值 103 亿)
- 注 14: 2019/8/8 晶晨股份 (688099.SH) 上市 (影响当月市值 358 亿)
- 注 15: 2019/11/20 清溢光电 (688138.SH) 上市 (影响当月市值 41 亿)
- 注 16: 2019/12/16 芯源微 (688012.SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 17: 2019/12/23 聚辰股份 (688123.SH) 上市 (影响当月市值 87 亿)
- 注 18: 2019/12/26 华特气体 (688268.SH) 上市 (影响当月市值 53 亿)
- 注 19: 2020/2/7 瑞芯微 (603893.SH) 上市 (影响当月市值 240 亿)
- 注 20: 2020/2/18 华峰测控 (688200.SH) 上市 (影响当月市值 155 亿)
- 注 21: 2020/4/20 沪硅产业-U (688126.SH) 上市 (影响当月市值 398 亿)
- 注 22: 2020/6/16 金宏气体 (688106.SH) 上市 (影响当月市值 262 亿)
- 注 23: 2020/7/16 中芯国际 (688981.SH) 上市 (影响当月市值 6115 亿)
- 注 24: 2020/7/22 芯朋微 (688508.SH) 上市 (影响当月市值 176 亿)
- 注 25: 2020/8/10 敏芯股份 (688286.SH) 上市 (影响当月市值 72 亿)
- 注 26: 2020/8/18 芯原股份-U (688521.SH) 上市 (影响当月市值 560 亿)
- 注 27: 2020/9/11 立昂微 (688126.SH) 上市 (影响当月市值 393 亿)
- 注 28: 2020/9/21 思瑞浦 (688536.SH) 上市 (影响当月市值 203 亿)
- 注 29: 2020/9/28 芯海科技 (688595.SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 30: 2020/11/11 利扬芯片 (688135.SH) 上市 (影响当月市值 78 亿)

上周 (2021/10/22-2021/10/29) 沪/深股通总体增持半导体板块。沪/深股通持股市值前 20 的企业中, 12 家企业获增持, 8 家企业被减持。增持金额前三公司为士兰微 (8.3 亿元)、晶盛机电 (3.9 亿元)、斯达半导 (3.6 亿元), 减持金额前三公司为韦尔股份 (-4.1 亿元)、卓胜微 (-3.5 亿元)、三安光电 (-3.3 亿元)。

图15: 沪/深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名)

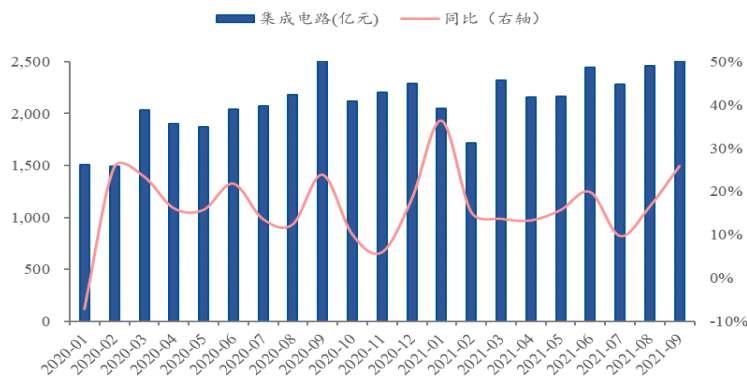
本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增减持金额 (百万元)	一月增减持金额 (百万元)	年初至今增减持金额 (百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占自由流通股比例 %
1	1	603501.SH	韦尔股份	-411	-1,896	5,446	16,156	12
2	2	002371.SZ	北方华创	135	-294	1,294	9,180	11
3	3	603986.SH	兆易创新	-77	-578	3,870	7,434	9
4	5	002008.SZ	大族激光	-119	-319	-287	6,861	18
5	4	300782.SZ	卓胜微	-347	-1,160	8,766	5,931	10
6	7	002129.SZ	中环股份	-140	-580	1,022	5,662	5
7	6	300316.SZ	晶盛机电	390	309	2,887	5,344	13
8	8	600745.SH	闻泰科技	25	-70	2,249	5,035	7
9	9	300661.SZ	圣邦股份	111	262	2,269	4,404	10
10	11	603290.SH	斯达半导	357	1,002		3,674	16
11	10	002049.SZ	紫光国微	288	429	1,829	3,648	4
12	12	600703.SH	三安光电	-327	-593	81	3,421	5
13	13	600460.SH	士兰微	834	829	919	2,017	5
14	14	688012.SH	中微公司	21	187		1,828	4
15	15	688008.SH	澜起科技	-84	-22		1,551	6
16	19	300458.SZ	全志科技	98	143	809	1,384	9
17	17	600584.SH	长电科技	74	77	1,485	1,331	4
18	18	300327.SZ	中颖电子	76	-82	829	1,313	9
19	20	603160.SH	汇顶科技	50	31	-28	1,106	5
20	21	300373.SZ	扬杰科技	-151	-11	401	1,068	8

注: 此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量*上周交易均价, 数据更新截止于 2021/10/29;

资料来源: wind, 民生证券研究院

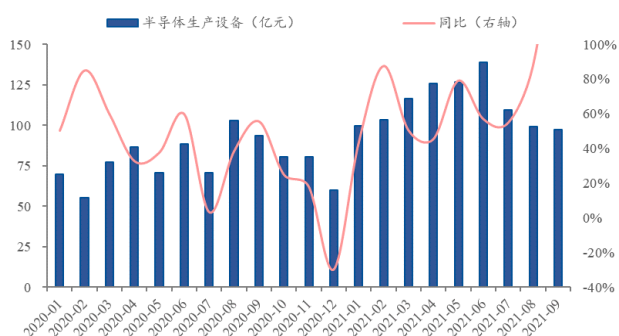
国内下游需求整体持续增长。根据海关总署最新数据显示, 2021年9月我国集成电路进口额为2703.22亿元, 同增25.95%; 半导体生产设备进口额97.25亿元, 同增178.52%; 处理器及控制器进口额为1136.99亿元, 同增8.52%; 存储器进口额为645.97亿元, 同增7.60%; 放大器进口额为74.41亿元, 同减21.25%。2021年1月-9月, 上述进口数据普遍同比增长, 反应国内需求仍在不断增大。

图16: 集成电路月度进口数据



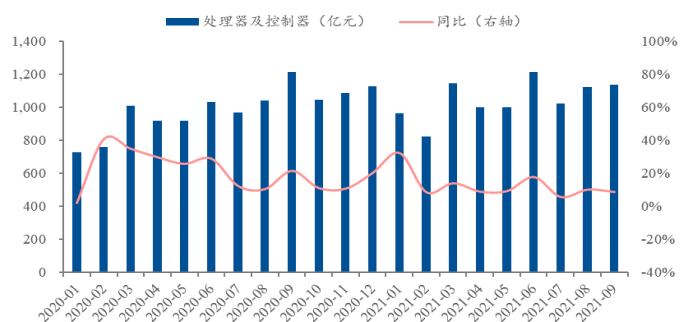
资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

图17: 集成电路-半导体生产设备月度



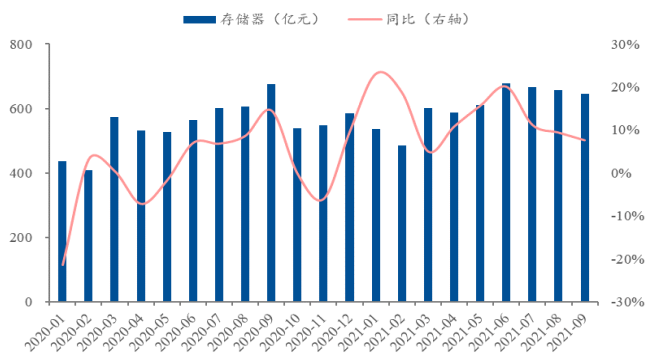
资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

图18: 集成电路-处理器及控制器月度



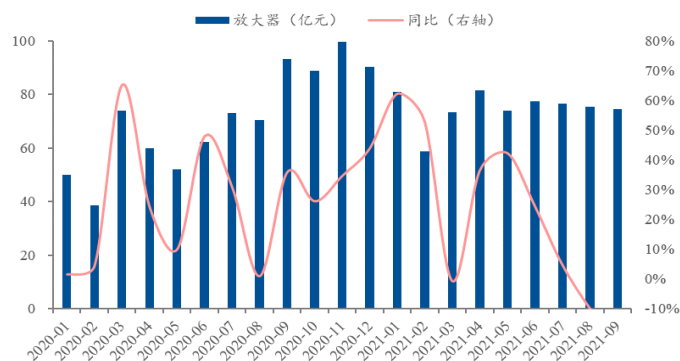
资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

图19: 集成电路-存储器月度进口数据



资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

图20: 集成电路-放大器月度进口数据



资料来源: 海关总署, 民生证券研究院

Q4 各类芯片交货周期延续此前态势。我们对比了各类产品 19Q1、20Q1 和 21Q1-Q4 的交货周期, 其中模拟芯片正常交货周期在 12-20 周, 目前为 12-52+周; 连接类芯片正常交货周期在 12-16 周, 目前为 18-52 周; MCU 正常交货周期在 10-16 周, 目前为 26-52+周; 存储类正常交货周期在 6-14 周, 目前为 12-54 周; 功率器件正常交货周期在 6-12 周, 目前为 12-52 周。PCB 元件交货周期趋于稳定, 但个别产品如: 汽车连接器、PCB 连接器、RF 连接器和 FFC/FPC 交货周期仍有拉长趋势。此外, 被动元件正常交货周期在 12-20 周, 目前为 12-52 周。

表1: 各类产品交货周期和价格情况 (天)

大类	公司	产品名字	19Q1	20Q1	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4	货期趋势	价格趋势
模拟	恩智浦	传感器	12-30	12-30	16-32	16-52	16-52	16-52		
		接口	10-12	10-12	14-16	36-52	36-52	36-52	↑	↑
		汽车模拟和电源芯片	20	20	20-26	45-52	45-52	45-52		
	英飞凌	传感器	8-39	8-39	8-39	18-38	18-52	18-52		
		交换式稳压器	18-20	25	25	20-52+	20-52+	20-52+	↑	↑
		汽车模拟和电源芯片	25	22-24	22-24	45-52	45-52	45-52		
意法半导体	传感器	14-20	14-26	20-24	26-34	26-34	26-34			
		信号链(放大器和数据转换器)	12-24	10-12	14-16	30-35	35-42	35-43	↑	↑

		多源模拟/电源	12-24	6-8	12-20	12-24	12-24	12-24			
		交换式稳压器	12-24	10-12	10-26	12-26	12-26	12-26			
		汽车模拟和电源芯片	25	22-24	22-24	40-52	40-52	40-52			
	瑞萨	信号链(放大器和数据转换器)			16-18	16-18	16-18	40-50		↑	
		计时器			20	20	20	50	↑	↑	
		接口			16-18	18-20	28-30	40-50		→	
		交换式稳压器			16-18	18-24	18-24	40-50		↑	
连接	恩智浦	多协议/芯片解决方案		12-14	30-32	52	52	52	↑		
		收发器/接收器	8-10	8-10	8-10	24	24	24	→	↑	
		无线射频识	10-12	10-12	10-12	52	52	26-52	↑		
		高功率集成电路	18	18	18	26	26	52	↑		
	英飞凌	蓝牙模块		10-12	26-30	26-30	26-30	26-30	↑	↑	
	意法半导体	蓝牙模块	12-16	12-16	20-26	30-40	30-40	30-40			
		收发器/接收器				52	52	52	↑	↑	
	微芯	无线射频识别	8-10	8-10	8-10	16-18	16-18	20-26			
		无线网络模块	18-20	18-20	20-24	24-26	24-26	24-26	↑		
		蓝牙模块	18-20	18-20	20-24	24-26	24-26	24-26	↑	↑	
		收发器/接收器	14-16	14-16	14-16	18-20	18-20	18-20	→		
MCU	恩智浦	8 位	14-16	14-16	26	26-52	26-52		↑	↑	
		32 位	13-16	13-16	16-26						
	瑞萨	8 位	24-26	20	12-16				↑	↑	
		32 位	24-26	20	12-16	26	26	35-40	↑	→	
	意法半导体	8 位	20-25	8-10					↑	↑	
		32 位	12	8-12	26		20-26	20-26			
	英飞凌	8 位	14-16	14-16	26-28		45	45	45	↑	→
		32 位	20-24	15-16	22-28						
	微芯	8 位	12-14	10-12	16-38	30-55	30-55	52+	↑	↑	
		32 位	12-16	10-12	16-38	40-55	40	52+			
	存储	微芯	Nor Flash	8-16	8-16	8-16	12-24	16-24	20-52	↑	↑
			EEPROM	6-12	6-12	6-12	12-52	12-52	26-52		→
EPROM			6-14	6-14	8-20	12-20	12-20	12-26	→		
英飞凌		SRAM	6-16	6-16	8-28	12-40	12-40	12-40	→		
		Nor Flash	10-18	8-14	10-18	20-52	20-52	32-52	↑	↑	
		FRAM&NVS RAM	6-12	6-12	15-28	16-36	16-36	16-36	→		
三星		PC DRAM		12-14	10-14	52-54	52-54		→	→	
		Memory Modules		14-16	14-16	52-54	52-54				
		eMMC		14-16	12-14	52-54	52-54	52-54	↑	↑	
		SSD		14-16	14-16	52	52		→	→	
功率器件	英飞凌	低压 Mosfet	39-52	10-30	16-39	39-52	39-52	42-52	→		
		高压 Mosfet	39-52	16-26	18-22	26-40	26-40	36-52			
		IGBT	39-52	18-30	18-26	39-50	39-50	39-50			
		宽带隙 Mosfet			24-30	36-50	36-50	36-50		↑	
		数字晶体管			10-16	12-52	12-52	12-52	↑		
		通用晶体管			12-18	12-52	12-52				
		军用-航空晶体管			20-40	30-50	30-50	30-50			

安世半导体	低压 Mosfet	36-52	8-20	12-26	42-52	42-52	42-52		
	ESD	12-26	12-26	6-14	16-50	16-50	16-50		
	肖特基二极管	16-52	4-8	8-16	16-52	16-52			
	开关二极管	16-52	4-8	12-30	16-52	16-52			
	小信号 Mosfet	20-52	4-8	8-14	16-52	16-52			↑
	齐纳二极管	13-52	4-8	8-14	16-52	16-52	16-52	↑	
	双极晶体管			8-16	16-52	16-52			
	数字晶体管	13-52	4-8	8-16	16-52	16-52			
	通用晶体管	13-52	4-8	8-16	16-52	16-52			
	逻辑器件	8-12	8-12	20	40-50	40-50	40-50		→
安森美半导体	低压 Mosfet	39-52	8-16	18-30	42-52	42-52	42-52		
	ESD	14-16	14-16	8-20	20-50	20-50	20-50	↑	
	宽带隙 Mosfet			24-34	36-50	36-50	36-50		
	肖特基二极管	16-40	6-12	12-30	16-52	16-52	16-52		
	整流器	18-42	5-15	12-39	8-52	8-52	20-43	→	
	开关二极管	16-40	6-12	12-30	16-52	16-52			↑
	小信号 Mosfet	18-40	8-16	12-30	16-52	16-52			
	齐纳二极管	12-40	6-12	12-40	16-52	16-52	16-52	↑	
	双极晶体管	12-40	8-12	10-30	16-52	16-52			
	数字晶体管	14-40	6-12	10-30	16-52	16-52			
通用晶体管	12-50	6-12	10-30	16-52	16-52				
逻辑器件	20	4-20	30-50	30-50	30-50	30-50			
意法半导体	低压 Mosfet	38-42	12-30	18-26	42-52	42-52	42-52		↑
	高压 Mosfet	38-44	14-22	14-26	26-36	26-36	26-36		→
	IGBT	44-50	12-22	18-24	36-42	36-42	36-42		
	ESD	16-20	16-20	13-20	20-40	20-40	20-40		
	宽带隙 Mosfet			30-39	42-52	42-52	42-52	↑	
	晶闸管/Triac	20-25	16-20	16-20	40-50	40-50	40-50		↑
	TVS 二极管	8	8	14-20	30-40	30-40	30-40		
	整流器	20-33	10-32	10-26	38-40	38-40	45-48		
双极晶体管	20-45	8-14	12-30	20-40	20-40	20-40			
PCB/ 连接器	汽车连接器	26-40	16-20	16-20	30-40	30-40	30-40	↑	→
	圆形连接器	40	40	20	28-30	28-30	28-30		↑
	Relays	52+	52+	40	36-38	36-38	36-38		
	D-Sub 连接器	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10		
	数据和电信	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10		→
	PCB 连接器	8-10	8-10	16-18	16-18	16-18	16-18	→	
	RF 连接器	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14		↑
	IC 插座	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8		→
	接线端子和压接端子	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16		
	照明连接器	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10		↑
Amphenol ICC	D-Sub 连接器	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10			
	数据和电信	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	→	↑
	PCB 连接器	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10			
	FFC/FPC	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10			

广瀨电机	PCB 连接器	8-12	8-12	8-12	12-14	12-14				
	RF 连接器		8-10	10-12	10-14	10-14	26	↑	→	
	FFC/FPC	8-12	8-12	10-12	12-14	12-14				
村田	滤波器	8-12	12-18	12-18	12-18	12-18	35-45	↑	→	
	电感/变压器	8-10	8-10	12-20	12-20	12-20	12-20		↑	
	表面贴装通用陶瓷电容(低于 1uf)	30+	10-12	14-16	24-26	24-26	24-26			
	表面贴装通用陶瓷电容(高于 1uf) *不包括 1206+尺寸	20-38+	10-16	16-18	4-26	30-33	30-33	→	→	
	引线陶瓷电容	18-20	18-20	20-24	20-24	20-24	20-24		→	
	专用电容	16-20	12-14	14-16	14-16	20-26	20-26		→	
	滤波器	12-20	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40		↑	
被动元件	TDK	电感/变压器	12-16	12-16	14-30	14-30	14-30	16-30		↑
		表面贴装通用陶瓷电容(低于 1uf)	40+	12-20	20-24	20-22	20-22	20-22		
	表面贴装通用陶瓷电容(高于 1u* 不包括 1206+尺寸)	40+	20-28	22-28	22-28	22-28	22-28	↑	→	
	薄膜电容				24-36	24-36	24-52+			
	滤波器				20-26	20-26	35-45		↑	
	威世	微调电阻和电位器	10-14	10-14	10-18	10-18	10-18	10-18		↑
		薄膜电容	12-16	12-16	12-16	12-20	16-24	20-30	↑	↑
超级电容		14-16	14-16	14-16	14-16	14-20	14-20		→	
模压钽电容			14-16	26	35-40	40-50	40-50	→	↑	
共形敷膜钽电容			42	52	14-16	14-16	14-16	→	→	
聚合物钽电容		12-14	14-16	20	20-30	20-30	20-30	↑	→	
电感/变压器		52-78	20-78	10-20	12-20	40	12-20	→	→	
固定电阻器		12-14	30-35	30-52	30-52	30-52	↑	↑		
	表面贴装通用陶瓷电容(低于 1uf)	20+	18	18-20	18-20	20-30	20-30	→		
	引线陶瓷电容	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	↑	→	
	专用电容	10-12	10-12	12-14	12-14	12-14	12-14	→		

资料来源: Future electronics, 民生证券研究院整理

2 行业新闻

1) 国内新增晶圆代工项目

近日,浙江丽水经开区与晶圆代工企业浙江广芯微电子签订项目合作协议书,浙江广芯微电子将在丽水经开区投资建设 6 英寸高端特色硅基晶圆代工项目。

值得一提的是,浙江丽水市政府将给予该项目政策支持,并已签署相关项目合作框架协议书和投资意向书。此外,浙江广芯微电子高端特色硅基晶圆代工项目还获得了 A 股上市公司民德电子的增资参股。

新闻链接: <https://www.dramx.com/Topic/20211024-29737.html>

2) 纳微半导体成功上市

美东时间 10 月 20 日，GaN 功率半导体厂商 Navitas Semiconductor（“纳微半导体”）成功在纳斯达克全球市场交易，股票代码为“NVTS”。有媒体报道称，纳微半导体的市值已超 16 亿美元（16.17 亿美元）。

资料显示，纳微半导体成立于 2014 年，是全球知名的氮化镓功率芯片企业。其 GaNFast 功率芯片被应用在 130 多种型号的移动充电器中。截至 2021 年 10 月，GaNFast 电源 IC 出货量已超过 3000 万颗。目前，纳微半导体已与全球顶级手机 OEM 厂商及 PC 设备制造商展开合作，包括戴尔、联想、LG、小米、OPPO 等。

新闻链接：<https://www.dramx.com/Topic/20211024-29737.html>

3) 台积电拉大领先差距：推 N4P 制程，2022 年下半年完成产品设计定案

台积电 26 日宣布推出 N4P 制程技术，成为 5 纳米技术平台之中的效能强化版本，并且加入业界最先进且最广泛的先进制程技术家族。藉由 N5、N4、N3 以及最新的 N4P 制程，台积电提供多样且强大的技术组合选择，协助客户实现产品的功耗、效能、面积以及成本优势。

台积电指出，N4P 的效能较原先的 N5 增快 11%，也较 N4 增快 6%。相较于 N5、N4P 的功耗效率提升 22%，晶体管密度增加 6%。同时，N4P 藉由减少光罩层数来降低制程复杂度且改善芯片的生产周期。N4P 展现了台积电持续追求及投资提升制程技术的成果。

N4P 制程技术设计可将基于 5 纳米制程的产品轻松移转，让客户能够更加善用既有资源，并且为其 N5 产品提供更快更节能的下一代产品。台积电完备的设计生态系统将提供 N4P 良好的矽智财与电子设计自动化支持，公司与开放创新平台伙伴协助加速产品开发周期，采用 N4P 技术生产的首批产品预计于 2022 年下半年完成产品设计定案。

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211027-29762.html>

4) 中兴通讯预计今年终端出货量超亿部，半数采用自研芯片

10 月 25 日，中兴通讯在分析师大会上表示，中兴终端将全面聚焦 5G，进一步强化手机在移动互联中的核心地位，持续构建全场景 5G 终端生态，预计 2021 年全年终端出货量超 1 亿部，其中 50% 采用自研芯片，覆盖个人通讯、家庭、车联网、工业监控等领域。

在今年上半年，中兴通讯消费者业务表现最为亮眼。期内，营收达到了 123.5 亿人民币，占到公司总业务营收的 23.7%，同比增长达到 66%。

除了芯片技术外，中兴通讯在众多核心技术领域有自己的布局和核心专利。本次会议主要提及终端业务的核心技术有全面屏下摄像技术、计算影像技术、高精度授时/高可靠性工业互联网技术，5G 射频、网关及网络性能技术、超可靠超低延时通信关键技术，终端人机交互技术、V2X 云控平台及车联网技术等一大批技术的突破。这些核心技术突破有助于增加中兴通讯终端产品的竞争力。

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/IC/20211026-29753.html>

5) 聚焦碳化硅领域，晶盛机电 34 亿投资新项目，小米、TCL 也出手了

近日，晶盛机电拟募集资金 57 亿元，扣除发行费用后拟全部用于碳化硅衬底晶片生产基地项目、12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目、年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目、以及补充流动资金。总投资 33.6 亿元的碳化硅衬底晶片生产基地项目无疑是晶盛机电本次投资的重头戏。

近日，小米长江产业基金投资了碳化硅厂商瞻芯电子，成为瞻芯电子的第四大股东，持股 6.80%。

此外，TCL 近日也投资了一家碳化硅功率器件厂商。10 月 25 日，碳化硅功率器件厂商泰科天润宣布，公司 D 轮融资获得了某国际半导体大厂和元禾重元的联合助力，新进跟投方还包括老股东遼问创投、新股东 TCL 创投。

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/igbt/20211027-29769.html>

6) 芯片代工巨头格芯闯美股 市值或超 260 亿美元

10 月 28 日，全球第三大芯片代工企业格芯登陆美股。根据格芯提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的流通股计算，格芯上市后市值将超过 260 亿美元，也由此成为今年美股第三大上市交易。

资料显示，格芯公司创立于 2009 年 3 月 2 日，总部位于美国纽约州 Malta，是一家半导体晶圆代工公司，目前是仅次于台积电、三星电子、联电的世界第四大晶圆代工厂。不过和台积电、三星不同的是，格芯放弃了追求高端芯片生产能力，而主要服务于相对中低端的芯片市场，后者对汽车制造商等行业更为重要。

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211029-29791.html>

7) 三星电子计划到 2026 年晶圆代工产能增加至目前的 3 倍

28 日，三星电子发布今年第三季度财报，数据显示，三星电子该季度营收 73.98 万亿韩元（约合人民币 4030 亿元），同比增长 10%；营业利润为 15.82 万亿韩元（约合人民币 863.3 亿元），同比增加 28.04%，创历史第二高位；净利润为 12.29 万亿韩元（约合人民币 669 亿元），同比增长 31.3%。其中，包括芯片业务在内的设备解决方案部门营收为 35.09 万亿韩元，运营利润为 11.58 万亿韩元；Harman 营收为 2.40 万亿韩元，运营利润为 0.15 万亿韩元。

在当天举行的财报电话会议上，三星常务 Han Seung-hoon 表示，为最大限度地满足客户不断增长的需求，计划到 2026 年将其代工产能增加至当前的三倍，扩大韩国平泽的生产能力，并考虑在美国设立新工厂。

先进制程方面，除了 2022 年上半年首批纳米产品量产计划外，三星电子预计在 2023 年生产第二代 3 纳米芯片。Han Seung-hoon 表示：“预计代工业务将通过 3 纳米 GAA 工艺确保技术领先地位，并通过积极的投资满足需求，继续实现强劲的业绩改善。”

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211029-29790.html>

8) 半导体初创公司芯德科技获小米、OPPO 等投资，金额超 10 亿元

继 8 月底获得小米等投资之后，近日，半导体初创公司江苏芯德半导体科技有限公司（以下简称“芯德科技”）再次迎来了新的投资者，成功完成 A 轮和 A+ 轮两轮融资。本次融资由金浦新潮、君海创芯领投，小米长江产业基金、OPPO、恒信华业、国投招商及峰岭资本、晨壹基金、国策投资等知名投资机构跟投，融资金额超十亿元。

芯德科技成立于 2020 年 9 月，公司主要从事凸块、WB 封装、倒装封装、系统级封装、异质性封装（2.5D/3D Chiplet）等高端封测技术以及测试（含 CP 及 FT）一站式服务，专注于高端集成电路芯片封装、测试，以消费电子、5G 终端、物联网终端等为主要应用方向。

据披露，芯德科技本次募集的资金将主要用于新一代封测技术的研发，加速芯德科技在更高技术领域的布局，为未来获得广阔的市场和创新空间；其次，将用于加大先进封测设备投入、扩充产能、满足更多的客户需求。此外，本次增资由多位产业背景股东加持，将进一步优化芯德科技的股权结构，提升芯德产业链上下协同能力，为未来的发展壮大打下坚实基础。

虽然仅成立一年时间，但芯德科技在半导体产业的布局已经初见成效。江苏芯德半导体科技有限公司董事长张国栋表示，公司已经与众多国内外一线芯片设计公司展开合作和前期的沟通探讨，后续将持续发展先进的封测核心技术，向着成为世界一流的封测企业的愿景努力奋进。

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211028-29783.html>

9) 上海“十四五”规划：聚焦神经芯片、DNA 存储等数字技术重大前沿领域

近日，上海市人民政府办公厅关于印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》的通知。

《通知》明确了重点领域，包括推动经济数字化转型，助力高质量发展；推动生活数字化转型，创造高品质生活；推动治理数字化转型，实现高效能治理。

同时，《通知》指出了重点工程，具体包括数据价值提升工程、数字技术策源工程、数字底座赋能工程、数字规则引领工程、应用场景共建工程、转型标杆示范工程。

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/Memory/20211027-29774.html>

3 三季度业绩高增，设计与功率板块领衔

3.1 设计

1) 乐鑫科技

1.Q3 单季：实现营收 3.47 亿元，同比+33.67%（主要系：一是公司所处的物联网行业处于增长阶段，本期销量实现增长；二是上游原材料价格上涨，公司视成本上升情况及供求关系相应调增产品价格）；归母净利润 0.47 亿元，同比+1.22%；基本每股收益 0.58 元；

2.前三季度：实现营收 9.78 亿元，同比 76.82%（原因同上）；归母净利润 1.48 亿元，同比 83.32%。

2) 紫光国微

1.Q3 单季: 实现营收 14.97 亿元, 同比+74.93%; 归母净利润 5.82 亿元, 同比+105.78%; 基本每股收益 0.96 元;

2.前三季度: 实现营收 37.90 亿元, 同比-4.67%; 归母净利润 14.57 亿元, 同比+112.90%。

3) 全志科技

1.Q3 单季: 实现营收 5.33 亿元, 同比+13.24%; 归母净利润 1.47 亿元, 同比+63.45%; 基本每股收益 0.44 元;

2.前三季度: 实现营收 15.81 亿元, 同比+47.85%; 归母净利润 3.89 亿元, 同比+121.16%。

4) 圣邦股份

1.Q3 单季: 实现营收 6.20 亿元, 同比+56.03% (主要原因系报告期公司业务增长、产品销量增加, 相应营业收入增加所致); 归母净利润 1.91 亿元, 同比+86.06%; 基本每股收益 0.81 元;

2.前三季度: 实现营收 15.35 亿元, 同比+77.95%; 归母净利润 4.51 亿元, 同比+117.93%。

5) 北京君正

1.Q3 单季: 实现营收 14.57 亿元, 同比+66.85%; 归母净利润 2.80 亿元, 同比+2459.80%; 基本每股收益 0.60 元, 同比+2,359.67%;

2.前三季度: 实现营收 37.93 亿元, 同比+208.85% (主要原因: 公司各产品线市场需求旺盛, 致公司营业收入保持增长。同时, 北京矽成自 2020 年 5 月 31 日开始纳入合并范围, 致同比变动较大); 归母净利润 6.35 亿元, 同比+2733.52%。

6) 汇顶科技

1.Q3 单季: 实现营收 12.30 亿元, 同比-40.63%; 归母净利润 1.95 亿元, 同比-61.23%; 基本每股收益 0.43 元, 同比-61.26% (主要系净利润下降影响所致);

2.前三季度: 实现营收 41.40 亿元, 同比-19.27%; 归母净利润 6.15 亿元, 同比-44.06%。

7) 思瑞浦

1.Q3 单季: 实现营收 4.06 亿元, 同比+165.36%; 归母净利润 1.57 亿元, 同比+285.29%; 基本每股收益 1.96 元, 同比+188.24%;

2.前三季度: 实现营收 8.91 亿元, 同比+95.82%; 归母净利润 3.12 亿元, 同比+91.46%。

营收增加主要系公司持续推进市场拓展及新产品投放, 使得收入大幅增长所致; 基本每股收益增加主要系公司净利润增长所致。

8) 兆易创新

1.Q3 单季：实现营收 26.89 亿元，同比+77.39%（主要原因：芯片产品市场需求增加，产品销量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所提高。第三季度存储芯片业务收入同比增加约 6.51 亿元，增幅 63.69%；微控制器业务收入同比增加约 5.48 亿元，增幅 221.95%）；归母净利润 8.62 亿元，同比+178.47%；

2.前三季度：实现营收 63.30 亿元，同比+99.45%（主要原因：芯片产品市场需求增加，产品销量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所提高。累计三个季度存储芯片业务收入同比增加约 19.34 亿元，增幅 82.73%；微控制器业务收入同比增加约 10.97 亿，增幅 222.03%；传感器业务同比增加约 1.13 亿元，增幅 33.87%）；归母净利润 16.48 亿元，同比+144.92%。

9) 瑞芯微

1.Q3 单季：实现营收 6.79 亿元，同比+23.07%（系芯片销售收入增加所致）；归母净利润 1.43 亿元，同比+49.45%；基本每股收益 0.34 元，同比+44.38%（主要系营业收入增加，净利润增长所致）；

2.前三季度：实现营收 20.57 亿元，同比+67.86%；归母净利润 4.08 亿元，同比+116.16%。

10) 芯朋微

1.Q3 单季：实现营收 2.09 亿元，同比+69.27%（主要系公司积极开拓白电、快充、工业客户，产品结构优化和销量增长所致）；归母净利润 0.59 亿元，同比+115.14%；基本每股收益 0.52 元，同比+92.59%（主要系公司净利润比上年同期增加）；

2.前三季度：实现营收 5.36 亿元，同比+91.49%；归母净利润 1.29 亿元，同比+117.72%。

11) 澜起科技

1.Q3 单季：实现营收 8.68 亿元，同比+129.16%（主要原因：一是津逮服务器平台产品线本报告期收入较上年同期增长 43 倍，二是互连类芯片产品线本报告期收入较上年同期增长 16.35%）；归母净利润 2.05 亿元，同比-25.93%；基本每股收益 0.18 元，同比-25.00%；

2.前三季度：实现营收 15.93 亿元，同比+8.46%；归母净利润 5.12 亿元，同比-41.62%；基本每股收益 0.45 元，同比-42.31%（主要是由于公司本年度前三季度净利润较上年同期减少）。

12) 国科微

1.Q3 单季：实现营收 9.24 亿元，同比+404.72%；归母净利润 1.92 亿元，同比+783.27%；基本每股收益 1.06 元，同比+775.08%；

2.前三季度：实现营收 18.76 亿元，同比+398.75%（主要系本报告期多个产品线收入增加较多所致）；归母净利润 1.81 亿元，同比+11918.10%；基本每股收益 1.01 元，同比+11,740.00%。

13) 芯海科技

1.Q3 单季：实现营收 1.88 亿元，同比+99.50%；归母净利润 0.36 亿元，同比+129.21%；基本每股收益 0.36 元，同比+71.43%（主要系公司营收规模增长、管理效率提升致净利润增长所致）；

2.前三季度：实现营收 4.63 亿元，同比+82.39%；归母净利润 0.83 亿元，同比+36.63%。

营收增加原因：2021 年 1-9 月实现销售收入 46,270.48 万元，较去年同期增长 82.39%；主要系因为 2021 年行业景气度高、需求持续旺盛，各产品线均实现增长：1、模拟信号链芯片，在工业测量、环境测量、锂电管理等方面保持持续快速增长；2、MCU 芯片，高性能 32 位 MCU 持续快速增长，在手机、工业控制、高端消费等领域持续快速增长；3、健康测量 AIOT 芯片，健康测量设备及鸿蒙等生态系统物联网智能设备需求持续稳定增长。

3.2 封测

1) 长电科技

1.Q3 单季：实现营收 80.99 亿元，同比+19.32%；归母净利润 7.93 亿元，同比+99.40%；基本每股收益 0.45 元（主要系：1、国内外客户需求强劲，订单饱满。同时，各工厂持续调整产品结构，降本增效，毛利率得到有效提升；2、公司严格控制各项营运费用，不断优化财务结构，降低财务费用。同时，公司完成非公开发行 A 股，致加权平均股数上升）；

2.前三季度：实现营收 219.17 亿元，同比+16.81%；归母净利润 21.16 亿元，同比+176.84%。

2) 深科技

1.Q3 单季：实现营收 43.13 亿元，同比+19.15%；归母净利润 2.44 亿元，同比-4.04%；基本每股收益 0.16 元；主要系公司存储芯片封测业务订单饱满，产能满负荷运转，出货量同比大幅增长且预计还会持续提升；

2.前三季度：实现营收 122.68 亿元，同比+13.18%；归母净利润 5.17 亿元，同比+15.92%。

3) 华天科技

1.Q3 单季：实现营收 32.49 亿元，同比+47.49%（主要为本报告期订单饱满，生产经营规模扩大所致）；归母净利润 4.15 亿元，同比+130.22%；基本每股收益 0.15 元；

2.前三季度：实现营收 88.67 亿元，同比+49.85%；归母净利润 10.28 亿元，同比+129.78%。

3.3 设备

1) 晶盛机电

1.Q3 单季：实现营收 17.04 亿元，同比+67.94%；归母净利润 5.10 亿元，同比+106.10%；基本每股收益 0.40 元，同比+105.26%；

2.前三季度：实现营收 39.91 亿元，同比+60.61%（主要系销量增加，销售收入增加）；归母净利润 11.10 亿元，同比+111.97%；基本每股收益 0.86 元，同比+109.76%。

2) 北方华创

1.Q3 单季：实现营收 25.65 亿元，同比+54.65%；归母净利润 3.48 亿元，同比+144.16%；基本每股收益 0.70 元，同比+143.39%；

2.前三季度：实现营收 61.73 亿元，同比+60.95%（主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加）；归母净利润 6.58 亿元，同比+101.57%（主要原因是：收入增幅大于成本费用的增幅）。

3) 芯源微：

1.Q3 单季：实现营收 1.96 亿元，同比+31.32%；归母净利润 0.18 亿元，同比-53.17%；基本每股收益 0.21 元；主要系半导体行业景气度持续向好,公司收入规模持续增长所致。

2.前三季度：实现营收 5.47 亿元，同比+158.20%；归母净利润 0.53 亿元，同比+18.80%。

4) 中微公司

1.Q3 单季：实现营收 7.34 亿元，同比+47.45%（主要系：（1）受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，7-9 月刻蚀设备收入为 4.94 亿元，较去年同期增长约 132.43%，（2）由于下游市场原因以及本年新签署的 Mini-LED MOCVD 设备规模订单尚未发货，7-9 月 MOCVD 设备收入为 0.84 亿元，较去年同期下降约 46.29%）；归母净利润 1.45 亿元，同比-8.02%；基本每股收益 0.22 元，同比-25.47%；

2.前三季度：实现营收 20.73 亿元，同比+40.40%（主要系：（1）受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，1-9 月刻蚀设备收入为 13.52 亿元，较去年同期增长约 99.01%，毛利率达到 43.97%；（2）由于下游市场原因以及本年新签署的 Mini-LED MOCVD 设备规模订单尚未发货，2021 年 1-9 月 MOCVD 设备收入为 3.04 亿元，较去年同期下降约 24.27%，但 MOCVD 设备的毛利率达到 32.21%，较去年同期有大幅度提升。2021 年 1-9 月新签订单金额达 35.2 亿元，同比增长超过 110%）；归母净利润 5.42 亿元，同比+95.66%；基本每股收益 0.96 元，同比+84.62%。

3.4 材料

1) 南大光电

1.Q3 单季：实现营收 2.66 亿元，同比+58.83%；归母净利润 0.38 亿元，同比增长 3412.09%；基本每股收益 0.10 元，同比+3,414.81%；

2.前三季度：实现营收 7.09 亿元，同比+65.11%（主要原因是：公司产品市场需求增长）；归母净利润 1.24 亿元，同比增长 38.58%。

2) 天华超净

1.Q3 单季：实现营收 8.91 亿元，同比+ 194.96%；归母净利润 2.38 亿元，同比增长 464.56%；基本每股收益 0.41 元，同比+ 412.50%；

2.前三季度：实现营收 23.22 亿元，同比+ 118.26%（主要系本期天宜锂业并表）；归母净利润 5.50 亿元，同比增长 139.51%；基本每股收益 0.97 元，同比+ 130.95%。

3) 立昂微

1.Q3 单季：实现营收 7.25 亿元，同比+ 88.65%；归母净利润 1.95 亿元，同比增长 257.31%；基本每股收益 0.49 元，同比+ 226.08%；

2.前三季度：实现营收 17.53 亿元，同比+ 69.76%（主要系行业景气度提升，市场需求旺盛，公司主要产品产销量大幅提升、产品结构优化及涨价因素）；归母净利润 4.04 亿元，同比增长 208.91%；基本每股收益 1.01 元，同比+ 180.56%。

4) 康强电子

1.Q3 单季：实现营收 6.04 亿元，同比+ 42.91%；归母净利润 0.53 亿元，同比增长 169.64%；基本每股收益 0.14 元，同比+ 180.00%；

2.前三季度：实现营收 16.61 亿元，同比+ 54.01%（主要系市场需求增加所致）；归母净利润 1.24 亿元，同比增长 73.60%；基本每股收益 0.33 元，同比+ 73.68%。

3.5 功率

1) 华微电子

1.Q3 单季：实现营收 6.09 亿元，同比+ 40.81%；归母净利润 0.35 亿元，同比增长 6031.25%；基本每股收益 0.03 元，同比+ 4,900.00%；

2.前三季度：实现营收 16.00 亿元，同比+ 29.52%（主要系市场需求旺盛，销售量上升，销售收入增加）；归母净利润 0.62 亿元，同比增长 222.53%；基本每股收益 0.06 元，同比+ 200.00%。

2) 士兰微

1.Q3 单季：实现营收 19.14 亿元，同比+ 51.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 2075.21%；基本每股收益 0.22 元，同比+ 2,100.00%；

2.前三季度：实现营收 52.22 亿元，同比+ 76.18%（主要系行业景气度持续向好，功率半导体等芯片国产替代加速，公司在特色工艺平台建设、新产品开发、战略级大客户合作等方面不断取得突破，加快产品结构调整，积极扩大产能，集成电路和分立器件等产品出货量持续增长）；归母净利润 7.28 亿元，同比增长 1543.39%；基本每股收益 0.551 元，同比+ 1,520.59%。

3) 派瑞股份

1.Q3 单季：实现营收 0.65 亿元，同比+ 248.79%；归母净利润 0.30 亿元，同比增长 334.68%；基本每股收益 0.0940 元，同比+ 335.19%；

2.前三季度：实现营收 1.36 亿元，同比+ 26.10%；归母净利润 0.41 亿元，同比增长 47.09%；基本每股收益 0.1296 元，同比+ 30.78%。

4) 新洁能

1.Q3 单季: 实现营收 4.22 亿元, 同比+ 49.84%; 归母净利润 1.36 亿元, 同比增长 198.78%; 基本每股收益 0.96 元, 同比+ 123.26%;

2.前三季度: 实现营收 10.99 亿元, 同比+ 65.05% (主要系公司产品供不应求, 销售规模扩大); 归母净利润 3.11 亿元, 同比增长 207.83%; 基本每股收益 2.19 元, 同比+ 130.87%。

5) 苏州固得

1.Q3 单季: 实现营收 7.41 亿元, 同比+ 48.73%; 归母净利润 0.70 亿元, 同比增长 150.42%; 基本每股收益 0.0862 元, 同比+ 125.07%;

2.前三季度: 实现营收 19.49 亿元, 同比+ 59.72%; 归母净利润 1.85 亿元, 同比增长 148.23%; 基本每股收益 0.2351 元, 同比+ 129.81%。

表2: 2021 年三季度半导体公司业绩 (亿元)

板块	公司代码	公司名称	21Q3 营业收入	YoY	QoQ	21Q3 归母净利润	YoY	QoQ
	603501.SH	韦尔股份	58.66	-1.01%	-5.93%	12.75	73.11%	6.00%
	603986.SH	兆易创新	26.89	77.39%	32.02%	8.62	178.47%	78.05%
	300782.SZ	卓胜微	11.24	15.33%	-4.43%	5.13	40.65%	-1.80%
	002049.SZ	紫光国微	14.97	74.93%	11.73%	5.82	105.87%	5.44%
	688008.SH	澜起科技	8.68	129.16%	104.32%	2.05	-25.93%	17.77%
	603160.SH	汇顶科技	12.30	-40.63%	-17.49%	1.95	-61.23%	-26.14%
	300661.SZ	圣邦股份	6.20	56.03%	18.86%	1.91	86.06%	3.03%
	002180.SZ	纳思达	51.18	2.08%	1.33%	2.49	343.11%	18.09%
	688099.SH	晶晨股份	12.32	50.23%	14.81%	2.52	411.68%	57.30%
	603893.SH	瑞芯微	6.79	23.07%	-16.57%	1.43	49.45%	-6.75%
	300327.SZ	中颖电子	4.08	42.05%	7.34%	1.15	104.05%	35.21%
	600171.SH	上海贝岭	4.95	40.47%	-16.17%	1.15	169.71%	-54.61%
	300223.SZ	北京君正	14.57	66.85%	14.94%	2.80	2459.80%	19.47%
	300458.SZ	全志科技	5.33	13.24%	-2.46%	1.47	63.45%	-5.76%
设计	688536.SH	思瑞浦	4.06	165.36%	27.91%	1.57	285.29%	26.96%
	300613.SZ	富瀚微	5.62	465.98%	11.08%	1.30	/	25.43%
	603068.SH	博通集成	2.79	21.43%	-1.92%	0.17	107.73%	-27.52%
	688018.SH	乐鑫科技	3.47	33.67%	-3.51%	0.47	1.22%	-30.91%
	300672.SZ	国科微	9.24	404.72%	71.08%	1.92	783.27%	/
	300077.SZ	国民技术	3.29	209.02%	79.05%	0.48	85.61%	-18.96%
	300183.SZ	东软载波	2.60	18.23%	73.86%	0.38	-8.02%	137.35%
	688521.SH	芯原股份-U	6.48	73.72%	19.79%	0.24	/	5.44%
	688508.SH	芯朋微	2.09	69.27%	13.79%	0.59	115.14%	44.33%
	688123.SH	聚辰股份	1.28	-12.84%	-2.55%	0.17	-76.90%	-65.80%
	300139.SZ	晓程科技	0.61	20.84%	13.06%	0.79	11539.41%	1173.01%
	688595.SH	芯海科技	1.88	99.50%	10.02%	0.36	129.21%	-29.23%
	688286.SH	敏芯股份	0.77	-25.03%	-22.38%	-0.02	-112.74%	-130.33%
	000670.SZ	*ST 盈方	7.94	1243.22%	16.16%	0.05	/	/
	300053.SZ	欧比特	1.91	-7.41%	1.25%	0.11	-37.71%	-26.96%
	300671.SZ	富满电子	3.31	26.44%	-43.32%	1.69	355.24%	-33.80%

	600198.SH	*ST 大唐	1.82	-22.31%	-5.78%	-0.36	/	191.98%
	688256.SH	寒武纪-U	0.85	20.22%	-16.90%	-2.38	/	/
	688368.SH	晶丰明源	7.59	135.47%	15.36%	2.38	1062.70%	-10.78%
	688589.SH	力合微	0.61	98.63%	-38.20%	0.01	/	-92.26%
	688608.SH	恒玄科技	4.98	50.22%	12.44%	1.05	54.05%	-4.03%
	688699.SH	明微电子	4.53	227.95%	8.81%	2.97	908.07%	25.52%
封测	002156.SZ	通富微电	41.14	49.60%	7.67%	3.02	101.03%	23.49%
	002185.SZ	华天科技	32.49	47.49%	7.53%	4.15	130.22%	25.53%
	600584.SH	长电科技	80.99	19.32%	13.96%	7.93	99.40%	-15.22%
	600667.SH	太极实业	59.24	40.38%	1.48%	2.01	0.14%	-26.10%
	603005.SH	晶方科技	3.85	24.57%	5.37%	1.46	30.04%	3.87%
	688216.SH	气派科技	2.28	43.15%	6.69%	0.41	45.17%	-13.69%
	000021.SZ	深科技	43.13	19.15%	4.46%	2.44	-4.04%	234.07%
	688135.SH	利扬芯片	1.12	116.86%	24.71%	0.38	939.09%	51.53%
	002371.SZ	北方华创	25.65	54.65%	17.40%	3.48	144.16%	46.54%
	603690.SH	至纯科技	3.62	51.68%	-47.48%	0.38	-27.72%	-50.06%
设备	688012.SH	中微公司	7.34	47.45%	-0.15%	1.45	-8.02%	-43.90%
	688200.SH	华峰测控	3.13	188.08%	49.95%	1.63	243.80%	33.84%
	300316.SZ	晶盛机电	17.04	67.94%	23.87%	5.10	106.10%	59.93%
	300604.SZ	长川科技	3.95	117.37%	4.47%	0.40	341.02%	-11.47%
	688037.SH	芯源微	1.96	31.32%	-17.36%	0.18	-53.17%	-36.93%
	688630.SH	芯基微装	1.05	114.31%	0.56%	0.20	42.34%	-33.47%
		002119.SZ	康强电子	6.04	42.91%	3.70%	0.53	169.64%
	300236.SZ	上海新阳	2.75	47.17%	18.86%	-0.23	-115.34%	-121.96%
	003026.SZ	中晶科技	1.29	87.62%	28.90%	0.41	72.39%	7.76%
	300346.SZ	南大光电	2.66	58.83%	14.85%	0.38	3412.09%	-10.37%
	300390.SZ	天华超净	8.91	194.96%	16.68%	2.38	464.56%	42.81%
	300666.SZ	江丰电子	4.00	28.23%	-1.45%	0.35	-49.91%	-19.58%
	300706.SZ	阿石创	1.88	72.66%	30.84%	0.06	-0.24%	28.05%
	300842.SZ	帝科股份	8.30	61.41%	12.66%	0.24	-23.26%	-36.62%
材料	600206.SH	有研新材	46.42	27.54%	16.53%	0.70	-15.59%	-12.95%
	603931.SH	格林达	2.00	25.75%	24.25%	0.39	30.36%	23.43%
	605358.SH	立昂微	7.25	88.65%	27.88%	1.95	257.31%	46.61%
	688126.SH	沪硅产业-U	6.44	42.36%	9.56%	-0.05	-105.73%	-104.81%
	688233.SH	神工股份	1.45	113.03%	21.25%	0.69	79.49%	13.61%
	300398.SZ	飞凯材料	6.84	32.81%	6.98%	1.02	72.52%	2.61%
	688019.SH	安集科技	1.88	60.34%	14.54%	0.25	-61.04%	-64.55%
	688268.SH	华特气体	3.47	32.94%	-1.83%	0.37	18.94%	-2.50%
	688106.SH	金宏气体	4.55	29.56%	6.67%	0.39	-35.49%	-20.03%
	688138.SH	清溢光电	1.59	30.83%	36.39%	0.10	-55.47%	27.30%
	603290.SH	斯达半导	4.78	89.85%	21.28%	1.13	110.54%	42.57%
	688187.SH	时代电气	32.28	-25.10%	-	5.07	-37.32%	-
	600460.SH	士兰微	19.14	51.98%	4.37%	2.97	2075.21%	15.42%
功率	688396.SH	华润微	24.73	35.44%	2.60%	6.16	117.26%	-7.74%
	605111.SH	新洁能	4.22	49.84%	17.10%	1.36	198.78%	37.18%
	300373.SZ	扬杰科技	11.61	64.24%	2.09%	2.20	86.59%	16.83%
	300623.SZ	捷捷微电	4.94	74.25%	1.58%	1.49	94.11%	7.27%

300046.SZ	台基股份	1.03	43.12%	16.96%	0.23	81.93%	36.29%
600745.SH	闻泰科技	138.77	-4.32%	8.60%	8.09	45.06%	39.29%
600360.SH	华微电子	6.09	40.81%	15.64%	0.35	6031.25%	124.16%
300831.SZ	派瑞股份	0.65	248.79%	21.12%	0.30	334.68%	173.66%
002079.SZ	苏州固锝	7.41	48.73%	14.61%	0.70	150.42%	8.23%

资料来源: wind, 民生证券研究院

4 投资建议

持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业:

- 1) 设计: 看好景气持续下价格持续上涨的弹性标的, 建议关注韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇顶科技等;
- 2) 功率: 产能紧张&涨价持续, 高景气趋势仍将持续。建议关注斯达半导、士兰微、中车时代电气、华润微、扬杰科技、新洁能、闻泰科技、捷捷微电等;
- 3) 设备: 景气持续下代工厂/封测厂扩产+国产替代下国内存储厂扩产, 建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、芯碁微装等;
- 4) 材料: 建议关注雅克科技、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、华特气体、金宏气体等;
- 5) 代工: 产能持续满载+国产替代, 建议关注中芯国际、华虹半导体;
- 6) 封测: 产能持续满载, 建议关注长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。

盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价 10月29日	EPS			PE			评级
			2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	
603501.SH	韦尔股份	266	3.11	5.19	7.36	85	51	36	推荐
603986.SH	兆易创新	170	1.32	2.92	4.21	128	58	40	推荐
300782.SZ	卓胜微	309	3.22	6.51	8.70	96	47	36	推荐
300671.SZ	富满微	82	0.49	4.85	7.08	166	17	12	推荐
688608.SH	恒玄科技	226	1.65	4.33	5.82	137	52	39	推荐
688595.SH	芯海科技	97	0.89	1.12	2.26	109	87	43	推荐
300661.SZ	圣邦股份	324	1.23	2.38	3.23	264	136	100	NA
688536.SH	思瑞浦	774	2.30	4.46	6.54	337	174	118	NA
688018.SH	乐鑫科技	164	1.30	3.53	4.86	126	46	34	推荐
603160.SH	汇顶科技	102	3.62	2.48	3.40	28	41	30	推荐
600460.SH	士兰微	62	0.05	0.67	0.86	1292	92	72	推荐
688396.SH	华润微	62	0.73	1.88	2.19	85	33	28	推荐
300373.SZ	扬杰科技	51	0.74	1.41	1.76	69	36	29	NA
603290.SH	斯达半导	400	1.13	2.18	3.03	354	184	132	推荐
605111.SH	新洁能	146	0.98	2.78	3.25	148	52	45	推荐
688187.SH	时代电气	54	1.75	1.60	2.04	31	34	26	推荐

600745.SH	闻泰科技	110	1.94	2.68	3.64	57	41	30	推荐
300623.SZ	捷捷微电	31	0.38	0.68	0.88	80	45	35	NA
002371.SZ	北方华创	371	1.08	1.70	2.42	344	219	153	NA
688200.SH	华峰测控	601	3.25	6.70	9.67	185	90	62	推荐
688012.SH	中微公司	156	0.80	0.90	1.15	196	173	136	推荐
688037.SH	芯源微	197	0.58	1.10	1.99	339	180	99	推荐
688630.SH	芯碁微装	53	0.59	0.92	1.27	90	58	42	推荐
002409.SZ	雅克科技	76	0.87	1.28	1.72	87	60	44	推荐
688019.SH	安集科技	237	2.89	2.84	3.97	82	83	60	NA
300666.SZ	江丰电子	40	0.65	0.76	0.99	62	53	40	NA
603650.SH	彤程新材	55	0.69	0.85	1.09	79	65	50	推荐
688268.SH	华特气体	69	0.89	1.28	1.70	78	54	40	推荐
688106.SH	金宏气体	22	0.41	0.53	0.66	53	41	33	推荐
300054.SZ	鼎龙股份	20	-0.17	0.31	0.44	-118	65	46	NA
688981.SH	中芯国际	55	0.55	1.32	1.46	100	42	38	推荐
1347.HK	华虹半导体	39	0.57	0.94	1.17	69	42	33	NA
600584.SH	长电科技	31	0.73	1.37	1.63	42	23	19	NA
002156.SZ	通富微电	20	0.25	0.64	0.89	79	31	22	推荐
000021.SZ	深科技	15	0.55	0.54	0.67	27	27	22	推荐
002185.SZ	华天科技	13	0.26	0.46	0.56	50	28	23	NA

资料来源：Wind、民生证券研究院

注：韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、汇顶科技、士兰微、华润微、斯达半导、新洁能、时代电气、闻泰科技、华峰测控、中微公司、芯源微、芯碁微装、雅克科技、彤程新材、华特气体、金宏气体、中芯国际、通富微电、深科技采用民生证券预测值，其他公司采用wind一致预期。

5 风险提示

下游代工厂扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度持续不及预期。

插图目录

图 1: 费城半导体指数持续上涨	3
图 2: 全球半导体月度销售额及增速	3
图 3: A 股半导体指数	3
图 4: 台湾半导体指数	3
图 5: 2021-10-29 细分板块估值情况	4
图 6: 上周半导体各细分板块涨跌幅情况	4
图 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司	4
图 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司	4
图 9: A 股半导体板块公司总市值 (十亿元)	5
图 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (十亿元)	5
图 11: A 股半导体设备制造板块公司总市值 (十亿元)	5
图 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (十亿元)	5
图 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (十亿元)	5
图 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (十亿元)	5
图 15: 沪/深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名)	7
图 16: 集成电路月度进口数据	7
图 17: 集成电路-半导体生产设备月度	8
图 18: 集成电路-处理器及控制器月度	8
图 19: 集成电路-存储器月度进口数据	8
图 20: 集成电路-放大器月度进口数据	8

表格目录

表 1: 各类产品交货周期和价格情况 (天)	8
表 2: 2021 年三季度半导体公司业绩 (亿元)	20

分析师与研究助理简介

王芳，电子行业首席，曾供职于东方证券股份有限公司、一级市场私募股权投资有限公司，获得中国科学技术大学理学学士，上海交通大学上海高级金融学院硕士。

杨旭，电子行业分析师，曾供职于东方证券股份有限公司，复旦大学理学博士。

王浩然，电子行业分析师，曾任职于东吴证券股份有限公司，2019年新财富环保行业第三名团队核心成员，获上海财经大学理学学士、金融硕士。

赵晗泥，电子行业研究助理，2020年加入民生电子，曾就职于外资行业研究，爱丁堡大学经济学硕士，复旦大学经济学学士。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来股价涨幅 15% 以上
	谨慎推荐	分析师预测未来股价涨幅 5%~15% 之间
	中性	分析师预测未来股价涨幅-5%~5% 之间
	回避	分析师预测未来股价跌幅 5% 以上
行业评级标准		
以报告发布日后的 12 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来行业指数涨幅 5% 以上
	中性	分析师预测未来行业指数涨幅-5%~5% 之间
	回避	分析师预测未来行业指数跌幅 5% 以上

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层； 100005

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元； 518001

免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。